

台灣發明協會 函

機關地址：241608新北市三重區重陽路一段1號4樓之11

承辦人：秘書處 吳秋瑾

電話：02-66057626

電子信箱：tia7626@yahoo.com.tw

受文者：國立勤益科技大學

發文日期：中華民國115年3月24日

發文字號：台發協字第1150003023號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：2026美國矽谷國際發明展簡章 1.邀請函2.報名表3.切結書(ATTCH12
b6a0af7079db059c4778d38743622d5c_0003023A00_ATTCH12.pdf、ATTCH13
b6a0af7079db059c4778d38743622d5c_0003023A00_ATTCH13.doc、ATTCH14
b6a0af7079db059c4778d38743622d5c_0003023A00_ATTCH14.doc)

主旨：敬邀 貴校參加「2026美國矽谷國際發明展」，請協助轉知師生踴躍報名參加。

說明：

- 一、2026美國矽谷國際發明展（SVIIF 2026）即將在8月開展，敬邀貴校師生參與，請惠予公告並鼓勵師生踴躍參加，以提倡發明創新風氣，並為國爭取最高榮譽。
- 二、主辦大會：國際發明聯盟總會(IFIA)。台灣授權單位：台灣發明協會
- 三、參展日期、地點：2026年8月14日~8月16日，美國聖克拉拉會議中心舉行，共為期3天。
- 四、即日起報名至2026年5月30日截止。(參賽簡章請參考附件)
- 五、報名相關問題歡迎洽詢本會承辦人：秘書處 吳秋瑾 小姐。電話：(02)6605-7626。電子郵件：tia7626@yahoo.com.tw。歡迎透過LINE官方好友：@tia1972 與我們聯繫。

正本：國立臺北科技大學、崇右學校財團法人崇右影藝科技大學、崇右學校財團法人崇右影藝科技大學附設專科進修學校、崇右學校財團法人崇右影藝科技大學附設進修學院、國立臺灣科技大學、中國科技大學、德明財經科技大學、中華學



校財團法人中華科技大學、中華學校財團法人中華科技大學附設專科進修學校、城市學校財團法人臺北城市科技大學、黎明技術學院、馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校、耕莘健康管理專科學校、耕莘健康管理專科學校宜蘭分部、東南科技大學、醒吾學校財團法人醒吾科技大學、景文科技大學、華夏學校財團法人華夏科技大學、台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學、明志科技大學、宏國學校財團法人宏國德霖科技大學、聖約翰科技大學、健行學校財團法人健行科技大學、長庚學校財團法人長庚科技大學、南亞科技學校財團法人南亞技術學院、龍華科技大學、明新學校財團法人明新科技大學、大華學校財團法人敏實科技大學、光宇學校財團法人元培醫事科技大學、廣亞學校財團法人育達科技大學、仁德醫護管理專科學校、修平學校財團法人修平科技大學、朝陽科技大學、弘光科技大學、嶺東科技大學、中臺科技大學、僑光科技大學、國立臺中科技大學、國立勤益科技大學、南開科技大學、國立雲林科技大學、國立虎尾科技大學、崇仁醫護管理專科學校、吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學、國立臺南護理專科學校、台南家專學校財團法人台南應用科技大學、財團法人中華醫事科技大學、敏惠醫護管理專科學校、南臺學校財團法人南臺科技大學、崑山科技大學、嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學、文藻學校財團法人文藻外語大學、樹人醫護管理專科學校、育英醫護管理專科學校、國立高雄科技大學、樹德科技大學、國立高雄餐旅大學、輔英科技大學、正修學校財團法人正修科技大學、國立臺東專科學校、國立屏東科技大學、慈惠醫護管理專科學校、大仁科技大學、美和學校財團法人美和科技大學、國立澎湖科技大學、聖母醫護管理專科學校、大漢學校財團法人大漢技術學院、中華台北著作權人協會、亞東學校財團法人亞東科技大學、致理學校財團法人致理科技大學、中信金學校財團法人中信科技大學

副本： 115/03/24
11:22:18

台灣發明協會 理事長 張家菊



2026年第5屆美國矽谷國際發明展

邀請函



發明先進：敬啟

美國是我國最大的貿易市場，每當有新產品問市，莫不以進入美國市場為第一考量，今年美國 SVIIF 即將在八月開展，本會將組團參加，盼有新產品之發明人或廠商，欲獲取美國市場者，美國矽谷國際發明展將是一項最佳選擇，想藉由參加此大展吸取經驗者，千萬不要錯失這一年一度的發明展出盛會。

往年美國發明展展出時，全球各地工商人士都前往參觀，各國新聞媒體均前往採訪報導，您有可能一夕之間舉世聞名，又可觀摩世界各國發明家的新作品以予學習改進參考，一舉數得。

今年我們除了傳承以往的優點外，本屆展覽預計有廿餘國參展，敬盼與您同行。

2026年 SVIIF 於 8月14日~16日開展

假聖克拉拉會議中心舉行

即日起接受報名至 5月30日截止



台灣發明協會
美國矽谷參展團

團長 張家菊 敬邀



Silicon Valley International Invention Festival 2026 美國矽谷國際發明展-參展辦法

- 一、宗旨：為宣揚我國工業技術能力、促進國際科技交流、爭取國家榮譽、增進國民外交、拓展發明新產品海外市場及提高新產品之行銷市場價值。
- 二、主辦單位：國際發明聯盟總會(IFIA)
- 三、台灣授權單位：台灣發明協會
- 四、團名：2026 美國矽谷國際發明展-台灣參展團
- 五、依據：美國矽谷國際發明展大會組團授權書
- 六、展覽會名稱：Silicon Valley International Invention Festival 2026
- 七、展出日期：2026 年 8 月 14 日~8 月 16 日
- 八、展出地點：USA, California, Santa Clara Convention Center

5001 Great America Pkwy, Santa Clara, California 95054, United States

九、費用：

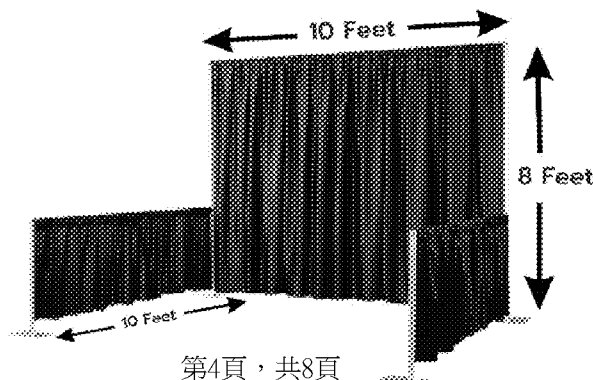
1. 參展費：每件作品**\$60,000 元**。
(包含報名費、展位費、評審費、入場證、1 桌 2 椅及電源費)。
2. 海報費：每件**\$1,000 元**(自理者免繳)。
3. 代展費：每件**\$10,000 元**。
(代展作品需提供 3 分鐘內影片，請上傳 YouTube 後提供網址。)
4. 個人旅費：預估 14 萬左右。欲隨團者，請提供隨團報名表及護照影本，後續由旅行社聯繫。如未達成團人數，將改為自行前往。
5. 作品攤位由協會安排，如需獨立攤位則需另加攤位費**\$30,000 元**。
6. 現場中英翻譯人員 160 美元/日(請自行交付翻譯人員，本會不代收。)

十、即日起接受報名至 2026 年 5 月 30 日截止。

※ 截止日前資料未繳交齊全者將無法刊登於矽谷展覽大會專刊。

※ 指定轉角攤位者須另加台幣 10,000 元。(有預訂並繳款者優先)

攤位示意圖：



繳交參展資料明細單：

請以電子檔交件：tia7626@yahoo.com.tw

寄件主旨請輸入□□□(個人名、學校名或公司名)報名美展。

文字部分請交 **word** 檔，照片圖檔請以 **jpg** 檔交件，每件作品請獨自建立一個資料夾，報名一件以上之作品，請於資料夾上輸入編號，以便雙方核對或通知補件，謝謝。

- ☐1. 已填妥之報名表(一件作品填寫一份報名表，需詳細填寫完整)
含產品介紹中、英文(約 150 字左右)
- ☐2. 參展切結書(請由該件作品一位發明人代表簽名或蓋章)
- ☐3. 參展品專利證書檔案或申請中收據(無專利者免附)
- ☐4. 參展品照片檔案(每件作品建議提供二張)
- ☐5. 隨團前往參展人員請附上隨團參展表(含護照影本)
- ☐6. 自行前往參展人員請提供人數及中英文姓名
- ☐7. 發明人或聯絡人名片
- ☐8. 聘請翻譯人員切結書(無聘請者免填)

報名日期：即日起接受報名至 5 月 30 日截止

聯絡地址：(241-608)新北市三重區重陽路一段 1 號 4 樓之 11

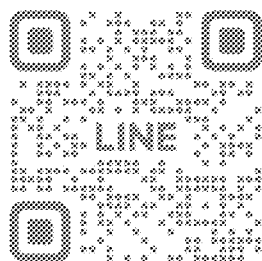
聯絡人：秘書處 吳秋瑾 小姐

聯絡電話：02-6605-7626

E-mail：tia7626@yahoo.com.tw

- 參展資料請連同全額參展費於報名截止日前繳交至本會，以完成報名手續。
(以上資料未齊全或未繳付全額參展費者，歉難受理報名。)
- 電匯資料：新光銀行(銀行代碼 103) 北三重分行
戶名：“**社團法人台灣發明協會**”。 帳號：“**0310-10-100304-3**”。

@tia1972



台灣發明協會
官方好友 LINE

發明人姓名 上限 10 位, 超過將取前 10 位。 請勿修改表格	發明人填寫姓名注意事項：範例：王小明 Hsiao-Ming Wang ※此欄為若得獎, 獎狀上的得獎者姓名, 一位以上之發明人, 請一律填寫於此, 資料一旦送出, 不得變更修改。		
	(中)		
	(護照英文名)		
公司/學校名稱	(中)	統一編號	
	(英)		
聯絡地址	(中)		
	(英)		
電話		手機	
E-mail		http://	
聯絡人	姓名：	職稱：	參展品類別 (請參閱選項 填入一編號)
	電話：		
	E-mail:		
是否隨團參展： ☐ 是，共____人。欲隨團者，請提供隨團報名表及護照影本，後續由旅行社聯繫。如未達成團人數，將改為自行前往。 ☐ 不跟團，共____人自行前往。(請提供名單) ☐ 委任協會代理。(另加代展費 10,000 元/件)			
海報： ☐ 自行排版製作輸出 ☐ 協會排版製作輸出(\$1,000) ☐ 自行排版檔給協會輸出(\$1,000)			
台灣專利	☐ 發明_____號 ☐ 新型_____號 ☐ 設計_____號		
專利名稱		☐ 公告中案號_____號 ☐ 申請中案號_____號	
展品名稱	(中)		
	(英)		
展品介紹	展品介紹(簡易中英文各約 150 字左右)		

CLASS - CHECK THE CATEGORY OF YOUR INVENTION (產品種類)

A	Mechanics(機械學) / Engines(引擎) / Machinery(機械) / Robotic(機器人學) / Tools(工具) / Industrial process(工業生產流程) / Metallurgy(冶金學)
B	Electronics(電子) / Electricity(電力) / Methods of Communication(電力通信方法)
C	Building(建築) / Architecture(建築學) / Civil Engineering(土木工程) / Construction(建造) / Materials(材料) / Woodwork(木工)
D	Sanitation(公共、環境衛生) / Ventilation(通風設施) / Heating(暖氣)
E	Security(安全) / Rescue(救援) / Alarm(警報裝置)
F	Housekeeping (家務管理) / Nutrition(營養學)
G	Commercial, Industrial and Office Equipment (商業、工業以及辦公室的設備)
H	Agriculture(農業) / Forestry and Garden(林業及園藝) / Pet and Farm Animal Supplies(寵物及家畜相關產品)
J	Traffic(交通) / Transport(運輸) / Car Accessories(汽車用品)
K	Graphic Arts(平面藝術) / Advertising(廣告)
L	Games(遊戲) / Sport(運動) / Hobbies(嗜好)
M	Medical Technology (醫藥科技) / Medical Engineering (醫學工程) / Medicine (藥品) / Hygiene (衛生)
N	Hardware(硬體) / Software(軟體) / Cybersecurity(網路安全) / Blockchain(區塊鏈) / Internet of things (IoT)(物聯網)
O	Teaching Research (教學研究) / Pedagogical Items (教學項目)
P	Energy (能源) / Renewable and green energy (再生及綠色能源)
Q	Paramedical (輔助醫療) / Health (健康) / Foodstuffs (食品) / Drinks (飲品) / Cosmetics (化妝品)

切 結 書

※一份作品請一位發明人代表填寫一份切結書

本人(公司)參加 2026 美國矽谷國際發明展，其報名表內填寫之所有內容，皆已再次確認無誤，同意報名表送出後，不得再做任何修改變更，含若得獎的得獎證書亦同。

同時願意遵守大會一切規定，並絕對尊重大會國際裁判的評審結果，絕無異議。

立書人

姓 名： (簽/蓋章)

身分證字號：

住 址：

電 話：

作品名稱：



中 華 民 國 年 月 日